

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2008年11月20日 (20.11.2008)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2008/139822 A1

- (51) 国際特許分類:
C08J 9/18 (2006.01) C08J 9/232 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2008/057398
- (22) 国際出願日: 2008年4月16日 (16.04.2008)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2007-125058 2007年5月9日 (09.05.2007) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社ジェイエスピー (JSP CORPORATION) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号 Tokyo (JP). 日本ポリプロ株式会社 (JAPAN POLYPROPYLENE CORPORATION) [JP/JP]; 〒1080014 東京都港区芝四丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐々木 秀浩 (SASAKI, Hidehiro) [JP/JP]; 〒5100881 三重県四日市市大字六呂見653-2 株式会社ジェイエスピー 四日市研究所内 Mie (JP). 中村 康則 (NAKAMURA, Yasunori) [JP/JP]; 〒5100848 三重県四日市市東邦町1 日本ポリプロ株式会社内 Mie (JP).
- (74) 代理人: 細井 勇 (HOSOI, Isamu); 〒1040061 東京都中央区銀座8-19-3 銀座竹葉亭ビル8階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書

(54) Title: POLYPROPYLENE RESIN FOAM PARTICLE AND MOLDED ARTICLE THEREFROM

(54) 発明の名称: ポリプロピレン系樹脂発泡粒子およびその成形体

(57) Abstract: Improved polypropylene resin foam particles that without detriment to the excellence in properties, such as compression properties and heat resistance, characterizing the polypropylene resin foam particles, can provide a polypropylene resin foam particle molded article with equal properties by an in-mold forming conducted at low heating temperature. There are disclosed polypropylene resin foam particles consisting of a polypropylene resin of 115° to 135°C resin melting point and 500 MPa or higher Olsen flexural modulus. The amount of ash at the surface of the foam particles is 3000 wt.ppm or less (including 0). With respect to the foam particles, in the first DSC curve obtained by heating 1 to 3 mg of polypropylene resin foam particles from room temperature to 200°C at a temperature elevation rate of 10°C/min by the use of a differential scanning calorimeter, there appear not only one or more endothermic peak (Pa) having the peak temperature within a temperature zone not higher than the melting point of the resin but also one or more endothermic peak (Pb) having the peak temperature within a temperature zone exceeding the melting point of the resin and not lower than 130°C. The total calorific value of the endothermic peak (Pb) is in the range of 2 to 12 J/g. Further, there is disclosed a foam particle molded article obtained by molding the above foam particles.

(57) 要約: ポリプロピレン系樹脂発泡粒子の特徴である圧縮物性、耐熱性などの優れた性質を損なうことなく、低い加熱温度での型内成形にて同等の性質を有するポリプロピレン系樹脂発泡粒子成形体を得ることができる優れたポリプロピレン系樹脂発泡粒子を提供することを目的とする。本発明は、樹脂融点が115～135°C、且つオルゼン曲げ弾性率が500MPa以上のポリプロピレン系樹脂からなるポリプロピレン系樹脂発泡粒子であって、該発泡粒子の表面のアッシュの量が3000重量ppm以下(0も含む)であり、該発泡粒子は、ポリプロピレン系樹脂発泡粒子1～3mgを示差走査熱量測定装置によって10°C/分の昇温速度で、常温から200°Cまで昇温したときに得られる第1回目のDSC曲線において、樹脂融点以下の温度領域に頂点温度を有する1以上の吸熱ピークPaが現れ、樹脂融点を超え、且つ130°C以上の温度領域に頂点温度を有する1以上の吸熱ピークPbが現れ、吸熱ピークPbの総熱量が2～12J/gであるポリプロピレン系樹脂発泡粒子、および該発泡粒子を成形してなる発泡粒子成形体に関する。

WO 2008/139822 A1